(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 12 月 11 日(11.12.2014)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2014/196299 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) *C09K 3/14* (2006.01)
B24B 37/00 (2012.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2014/062176

(22) 国際出願日: 2014 年 5 月 2 日(02.05.2014)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2013-120328 2013 年 6 月 7 日(07.06.2013) JP
特願 2014-010836 2014 年 1 月 23 日(23.01.2014) JP

(71) 出願人: 株式会社フジミインコーポレーテッド **(FUJIMI INCORPORATED)** [JP/JP]; 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目１番地１ Aichi (JP).

(72) 発明者: 土屋　公亮 **(TSUCHIYA, Kohsuke)**; 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目１番地１　株式会社フジミインコーポレーテッド内 Aichi (JP). 丹所　久典 **(TANSHO, Hisanori)**; 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目１番地１　株式会社フジミインコーポレーテッド内 Aichi (JP). 市坪　大輝 **(ICHITSUBO, Taiki)**; 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目１番地１　株式会社フジミインコーポレーテッド内 Aichi (JP). 森　嘉男 **(MORI, Yoshio)**; 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁目１番地１　株式会社フジミインコーポレーテッド内 Aichi (JP).

(74) 代理人: 安部　誠 **(ABE Makoto)**; 〒4600002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２０番３号４７ＫＴビル１０階　特許業務法人協働特許事務所 Aichi (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

WO 2014/196299 A1

(54) **Title**: COMPOSITION FOR SILICON WAFER POLISHING

(54) 発明の名称 : シリコンウエハ研磨用組成物

(57) **Abstract**: Provided is a composition for silicon wafer polishing, which is used in the presence of abrasive grains. This composition contains, a silicon wafer polishing accelerator, an amide group-containing polymer, and water. The amide group-containing polymer has a constituent unit (A) in the main chain. The constituent unit (A) contains a main chain-constituting carbon atom that constitutes the main chain of the amide group-containing polymer, and a secondary amide group or a tertiary amide group. A carbonyl carbon atom that constitutes the secondary amide group or the tertiary amide group is directly bonded to the main chain-constituting carbon atom.

(57) 要約:　砥粒の存在下で用いられるシリコンウエハ研磨用組成物が提供される。この組成物は、シリコンウエハ研磨促進剤と、アミド基含有ポリマーと、水と、を含む。また、前記アミド基含有ポリマーは、構成単位Ａを主鎖に有する。前記構成単位Ａは、前記アミド基含有ポリマーの主鎖を構成する主鎖構成炭素原子と、第二級アミド基または第三級アミド基と、を含む。そして、前記第二級アミド基または第三級アミド基を構成するカルボニル炭素原子は、前記主鎖構成炭素原子に直接結合している。